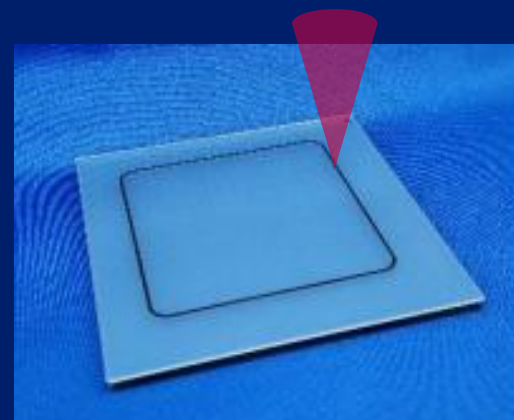


AGC局所加熱用シール ペーストのご紹介

電子カンパニー 電子部材事業本部
アドバンストマテリアル事業部
半導体部材統括部 フリット部

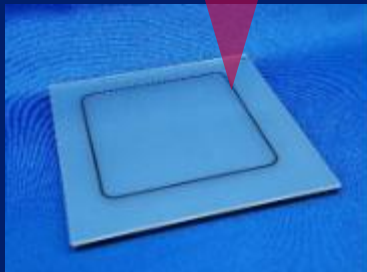
AGC株式会社



AGC

Your Dreams, Our Challenge

製品の特徴



1 素子への熱ダメージなくシール可能

局所加熱により、実装した素子へ**熱ダメージを与えず**に封止可能

2 高い気密性・信頼性を付与

高い気密性・耐湿性を付与することができ、
耐湿性の乏しい素子を**確実に、長期間保護**します。

3 幅広い素子サイズに対応

様々な素子サイズに対応可能な、**広いシールマージン**・商品ラインナップ

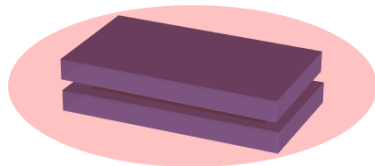
4 低温での仮焼成可能

所望の形態にあわせ、複数の製品ラインナップ
がありますのでお気軽にお問い合わせください。

レーザー加熱による気密封止の特長

従来技術

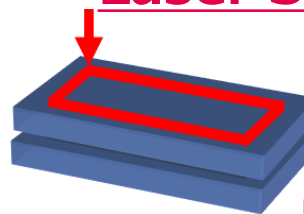
Furnace Sealing



400~500℃にて、
シール材料を含む、基板全体を加熱
耐熱性の低い素子を封入**不可**

Our Proposals

Laser Sealing






シール材のみを局所加熱
内部は室温のまま封止可能！

Point !

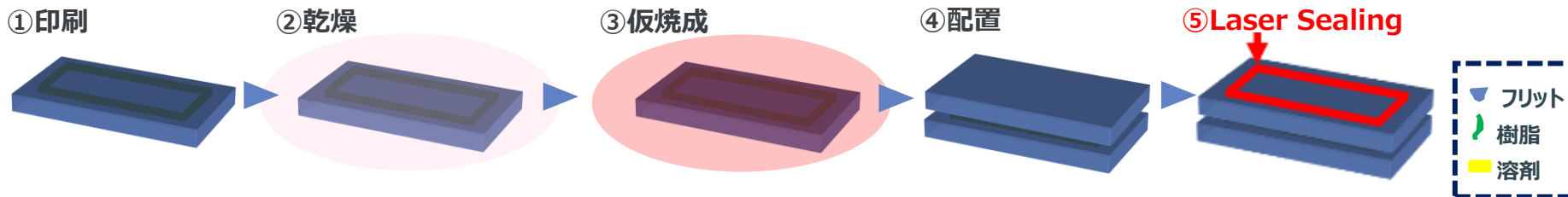
- 内部へ熱ダメージを与えずにシール可能。
- 高い気密性・信頼性を付与可能。

Point !

	樹脂封着	ガラス封着
水透過性 g/m ² /day	<10 ⁻¹	<10 ⁻⁵
対候性 60℃×90%RH	1000hr	10000hr<

ガラスシールによる保護の対象	アプリケーション例
有機EL素子	 OLED
ペロブスカイト構造	 Perovskite solar cell  Q-LED

レーザーシールプロセス



工程	目的	装置	イメージ図 (断面)
①印刷	基板にガラスペーストを印刷し、 所望のパターンを形成	スクリーン印刷機、または ディスペンサー	
②乾燥	溶剤の除去	乾燥機 (120~180 °C)	
③仮焼成	基板の樹脂の除去 およびガラスの焼結	焼成炉 (350~500 °C)	
④配置	熱に弱い素子を有する基板に、 仮焼成済みの基板を配置	-	
⑤レーザーシール	レーザー照射による ガラス溶解と基板間の接合	レーザー装置	

END

お客様の夢の実現のために
尽力してまいります

千代田区丸の内一丁目5番1号
新丸ノ内ビルディング

AGC

Your Dreams, Our Challenge